

长电科技 2021 年度业绩说明会记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日（星期四）15:30-16:30 通过上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会，公司首席执行长（CEO）郑力先生、独立董事李建新女士、首席财务长周涛女士、董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员就公司 2021 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

1、请问贵公司在汽车半导体方面的布局和发展情况如何？

回复：公司在汽车电子领域拓展迅速，已支持客户量产汽车电子相关产品多年，通过多个车载电子相关认证，量产产品可靠性已达到国际标准，主要客户覆盖海内外多家汽车半导体和零部件和整车供应商。2021 年上半年长电科技成立“汽车电子事业中心”，进一步完善车载电子业务的统一规划和运营。去年公司来自于汽车电子的收入增长近 50%。长电科技可以为车载电子客户提供的技术服务丰富多样，产品类型覆盖智能座舱、ADAS、传感器和功率器件等多个应用领域，一直在与主要客户开展密切合作，开发具有更高可靠性标准的电动汽车和自动驾驶相关封装技术。比如基于 eWLB 的 Radar 系统方案，应用于车载安全系统（安全气囊）、驾驶稳定检测系统的传感器的 SOIC 方案，应用于 LiDAR 的 LGA 方案。另外星科金朋韩国厂目前获得了多款欧美韩车载大客户的汽车产品模组开发项目，主要应用为智能座舱和 ADAS。在中国大陆的厂区已完成 IGBT 封装业务布局，同时具备碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）芯片封装和测试能力，目前已在车用充电桩出货第三代半导体封测产品。虽然汽车的投入很大，认证周期也比较长和严格，但是公司有信心逐渐提升汽车在公司收入的占比，并预计来自汽车相关的收入未来持续贡献高速增长。

2、请问 2021 年度先进封装占比营收比例是多少？毛利率是多少？先进封装种类很多种，先进封装毛利最高达到多少，先进封装毛利最低达到多少？

回复：公司去年先进封装包括除打线与测试外的其它封装形式，收入占比

60%以上,传统打线 30%,剩余的为测试。今年预期先进封装的占比进一步提升,实现高于公司平均水平的增长。公司不披露各封装类型的利润率水平。

3、您怎么看这一轮的半导体景气周期?您认为下半年景气度会是怎么样的?主要的增长驱动因素会来自于哪里?

回复:虽然根据主流预测机构的展望,今明两年全球半导体市场依然会维持稳定增长,但是目前观察到国内消费类产品市场以及通讯产品如手机市场呈现一定下滑倾向,部分芯片客户库存水准偏高,这对公司国内工厂的业务增长带来一定压力。公司将充分发挥国内国际双循环布局的优势,灵活调整订单结构和产能布局,满足应对不同客户的需求变化。公司将持续聚焦高附加值和快速增长的市场热点应用,预计 5G 通讯,高性能运算,汽车电子和国内存储市场的发展,在行业上行期不断优化产品结构和业务比重,提升自身生产和管理能力,通过布局新的产品和技术,不断提升竞争力,增强自身抵御周期波动的能力。

4、请问长电科技未来用于研发的费用占比是否将计划增加?重点研发方向是哪些?

回复:您好,2021 年公司研发费用为 11.9 亿元,同比增加 16.3%,是国内封测行业中研发投入最大的公司。2021 年度公司研发投入主要集中在 5G 射频、天线封装(AiP),高性能计算(HPC)和汽车应用等新兴市场以及在先进封装和测试解决方案中保持技术领先地位。公司未来将持续加大研发投入。今后公司将面向 5G/6G 射频高密度系统的封装及系统级测试,2.5D/3D chiplet,高密度多叠加存储技术等先进技术开展前瞻性研发,尽快完成产品验证并实现量产;各工厂积极投入到新工艺新材料研发项目上,推动技术和产品进一步提升,持续提升市场竞争力。

5、请问疫情对公司有无影响?公司有采取哪些措施来将影响最小化?

回复:您好,上海,江苏等地疫情形势不容乐观,公司虽未有工厂因此而停产但部分客户遇到了报关,物流受阻的情况,公司供应链的来料,运输效率和物流成本管控也受到一定影响,一些地区的管控措施也造成了员工出勤的不便。公

司积极响应遵守各地政府的各项防疫政策，努力配合客户和供应商在配送等方面的短期困难，同时通过江阴市慈善总会向江阴工厂所在地江阴高新区提供捐款支持防疫工作。公司将采取各种措施，积极缓解本轮疫情给国内工厂带来的影响。谢谢！

6、请问公司今年的资本开支能达到某研报所说的 60 亿吗？今年的资本开支将投向哪些领域？谢谢！

回复：2022 年公司计划资本开支 60 亿，其中的产能扩充资本开支中按照封装类型 70% 投资于先进封装，20% 在传统封装，剩下投资于测试。按照下游应用，主要聚焦在 5G，高性能运算，存储，汽车电子等方向。

7、请问公司如何看待近期市场对半导体行业未来产能过剩的担忧？公司是否有信心能在未来几年稳定增长，信心来源于哪？谢谢！

回复：集成电路产品在电子产品的价值占比逐年增加，同时 5G、汽车电子、高性能计算和 AI 等领域不断增长的需求将推动半导体市场在未来几年继续保持增长。中长期看集成电路制造型企业需要不断扩充产能，应对快速增长的需求以及应用驱动市场的发展。

8、感谢郑总，请问公司目前在设备和材料方面的国产化情况如何？

回复：“您好！公司一直充分借助中国内地最大集成电路封测企业地位，聚焦芯片属地化生产需求，持续对设备，材料供应商进行可行性评估、分析、验证与导入，充分发挥长电科技全球先进制造和技术资源优势，加速高端制造和设计技术在国内的研发和量产，支撑相关封测设备/材料/软件的产业链合作。

公司对设备的选择主要优先服务于客户需求，旨在最大化增加客户附加价值；同时在全球供应短缺的大背景下，公司为了进一步保证供应链的连续性和安全性，公司作为行业内部领先的龙头企业持续推动产业链的合作积极推进设备，材料多元化和本地化的战略布局和实施。”

9、你好，周总。截止目前公司有多少投资者？

回复：您好，公司已于 2022 年 3 月 31 日披露 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月末，公司股东总户数为 385,112 户；截至 2022 年 2 月末，股东总户数下降至 375,979 户。根据《公司法》及本公司《章程》相关规定，如公司股东需查阅非季度末股东总人数，请携带股东账户卡、股东证明及本人身份证原件至公司董事会办公室核实股东身份后可进行查询。感谢您的理解与支持！

10、你好，公司目前二级市场市值常年保持高速下跌，请问公司运营情况如何？公司在第三代半导体方面有啥布局？另外公司有布局半导体产业链上中游的产业吗？

回复：您好，受节假日等因素影响，一季度是半导体的淡季，目前公司订单稳定，产能利用率维持在较好的水平。具体运营数据请关注将于 2022 年 4 月底公布的 2022 年第一季度业绩报告。目前国内消费类产品市场以及通讯产品如手机市场呈现一定下滑倾向，部分芯片客户库存水准偏高，这对公司国内工厂的业务增长带来一定压力。公司将充分发挥国内国际双循环布局的优势，灵活调整订单结构和产能布局，满足应对不同客户的需求变化。公司在第三代半导体方面已经有了较好的布局。公司积极强化与产业链上中游的合作。谢谢！

11、郑总好。1) 今年来很多设计厂商自建封测产线，对封测行业及公司影响如何？2) 传统封装和先进封装的未来发展趋势如何？共存 or 替代？

回复：“集成电路封测行业是技术密集、资金密集和人力密集的行业，对投资，人员和资金都有相应的要求。一些 IC 设计厂通过投资封测产品，可以对自己一些小批量的产品做一些封装测试，和我们是一个互补。大批量的封测产品看，代工模式的效率更高。专业的封测代工企业可以为客户提供全方位封装测试，具有更好的规模效应。这样的分工模式在全球集成电路产业过去几十年的发展过程中得到了良好的验证。

随着智能手机，物联网，人工智能，汽车电子等新兴市场应用的发展，全球封装测试产业链持续成长，根据 Yole 的数据 2021 年全球封装市场规模成长 14.8% 达到 777 亿美元，同时其预计封测市场将在 20-26 年保持 6% 复合增长率在 2026

年达到 954 亿美元，未来半导体封装市场将持续向着小型化，集成化和低功耗的方向发展，在更多新兴应用和半导体技术发展的带动下，附加值更高的先进封装得到更为广泛的应用。预计先进封装市场规模的复合增速达到 8%，高于传统封装的增速，并在 2026 年占整个封测市场需求的 50%。”

12、郑总好。目前不少封测厂商上市扩产/业务线、智路资本收购日月光大陆封测厂、三方测试也涌入市场，如何看待未来的封测行业市场？

回复：公司看好测试市场的发展机会，公司具有卓越的晶圆级和芯片成品制造测试能力，依靠我们一站式的封装测试能力客户提供 turnkey solution。并考虑和客户共同投资，分散风险。公司今年在测试领域的资本开支较去年显著提升，引入更多的 5G 射频，汽车芯片，高性能计算芯片的测试业务，支持我们测试业务的快速发展。